

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2020-037

杭州立昂微电子股份有限公司 关于在海宁市设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●设立子公司名称：海宁立昂东芯微电子有限公司（暂定名，以市场监管部门核定为准，以下简称“海宁公司”）

●注册资本：50,000 万元

●特别风险提示：

1、该事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

2、海宁公司所涉项目建设周期等存在不确定性，项目实施存在一定的市场风险、经营风险以及投资后未达预期收益的风险。

3、海宁公司正式运营后，可能会受到产业政策、市场价格波动、经营管理、内部控制等多方面的风险。公司将完善其治理结构、明确经营策略、提高风险管控等方式来预防和控制潜在的风险，促进海宁公司投资项目稳定推进。

一、设立全资子公司概述

（一）基本情况

根据公司整体经营发展战略规划，杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江省海宁市人民政府、浙江省海宁经济开发区管理委员会于2020年12月24日在浙江省海宁市签订《关于微波射频集成电路芯片项目投资协议书》（以下称“投资协议”），投资项目名称为“微波射频集成电路芯片项目”（以下简称“项目”）。为此，公司拟在浙江省海宁经济开发区注册设立海宁立昂东芯微电子有限公司（暂定名，以市场监管部门核定为准，以下简称“海宁公司”），注册资本为50,000万元人民币，专项负责推进、实施所投资项目。

（二）审议和表决情况

本次投资设立全资子公司事项已经公司第三届董事会第二十一次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议批准。该事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

（三）其它审批及有关程序

本次投资设立全资子公司事项不需要经过政府有关部门的批准，仅需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，注册信息以市场监督管理部门最终核准登记内容为准。

（四）本次设立海宁公司不属于关联交易，不构成重大资产重组。

二、有关投资项目概要：

（一）项目名称：微波射频集成电路芯片项目

（二）项目选址：海宁经济开发区东区红狮产业园地块

（三）项目用地：200亩（以实测为准）

（四）项目投资方：杭州立昂微电子股份有限公司

（五）项目总投资：约43亿元人民币，其中设备投资36.05亿

元人民币，土地及生产、动力、环境等各类厂房投资 3.8 亿元人民币，流动资金和其他配套投资 3.15 亿元人民币。

（六）投资规模及主要内容：年产 36 万片 6 英寸砷化镓/氮化镓微波射频集成电路芯片。其中包括年产 18 万片砷化镓 HBT 和 pHEMT 芯片，年产 12 万片垂直腔面发射激光器 VCSEL 芯片，年产 6 万片氮化镓 HEMT 芯片。

（七）投资进度：本项目由公司全资子公司海宁公司在五年内分阶段实施，其中第一阶段工程 18 万片/年，第二阶段工程 18 万片/年。产品结构和实施进度，依据市场，适度调整。

（八）市场定位及可行分析：基于对微波射频集成电路行业的充分调研和对市场发展前景的充分论证，加上受限于既有生产基地的发展空间，公司亟需优化产品结构与产业布局，快速提升微波射频集成电路的产能，提高其市场占比，以更好地满足市场日益旺盛的需求。

三、本事项对上市公司的影响

由于海宁公司负责推进、实施的项目建设尚需较长的时间周期，同时考虑到项目建成后的产线达产、市场开拓等诸多因素的影响，短期内本事项涉及的项目不会对公司经营业绩构成实质的影响，预计对公司本年度以及 2021 年度的经营业绩也不会构成重大影响。

本事项是公司计划中的战略布局投资，不会导致公司的主营业务发生重大变化，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、本事项的可能风险分析

（一）本事项涉及的投资项目建设期较长，计划五年内实现全部建成投产。后续进展存在受宏观经济、行业周期、市场变化影响等不

确定因素，项目实施存在一定的市场风险、经营风险以及投资后未达预期收益的风险。因此，公司将时刻关注经济形势的变化，以国家政策为指引，以市场需求为导向，及时调整投资策略、提升服务品质等手段降低投资风险。

（二）海宁公司正式运营后，可能会受到产业政策、市场价格波动、经营管理、内部控制等多方面的风险。公司将完善其治理结构、明确经营策略、提高风险管控等方式来预防和控制潜在的风险，确保促进海宁公司的平稳运行。

（三）公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和上海证券交易所的相关规定，及时披露设立全资子公司的进展或变化情况，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

五、备查文件

- 1、《杭州立昂微电子股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《关于微波射频集成电路芯片项目投资协议书》

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2020年12月31日